

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【公開番号】特開2004-251789(P2004-251789A)

【公開日】平成16年9月9日(2004.9.9)

【年通号数】公開・登録公報2004-035

【出願番号】特願2003-43210(P2003-43210)

【国際特許分類第7版】

G 0 1 K 1/14

G 0 1 K 7/16

H 0 1 L 21/027

H 0 1 L 35/28

H 0 1 L 35/32

【F I】

G 0 1 K 1/14 L

G 0 1 K 7/16 B

H 0 1 L 35/28 Z

H 0 1 L 35/32 A

H 0 1 L 21/30 5 6 7

【手続補正書】

【提出日】平成16年8月12日(2004.8.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

温度調節ステージ(400)に基板(402)を設置して、前記基板(402)又は前記温度調節ステージ(400)の温度を測定する装置において、

前記基板(402)表面若しくはその近傍、又は前記温度調節ステージ(400)表面若しくはその近傍に、有意な面積を持った二次元温度センサ(600)を備え、前記二次元温度センサ(600)の面積に対応する前記基板(402)又は前記温度調節ステージ(400)の領域の温度を測定する温度測定装置。

【請求項2】

前記基板(402)を処理するプロセス中で、前記温度を測定するようになっている請求項1記載の温度測定装置。

【請求項3】

前記二次元温度センサ(600)が、フィルム状又は板状の基体(601)に担持されたものであって、前記温度調節ステージ(400)の表面上に配置されていることを特徴とする請求項1記載の温度測定装置

【請求項4】

温度調節ステージ(400)上で温度調節されつつ処理される被処理基板であって、

前記被処理基板の表面又は内部に、有意な面積を持った二次元温度センサ(600)を備え、前記二次元温度センサ(600)の面積に対応した前記被処理基板の領域の温度を測定するための被処理基板。

【請求項5】

温度調節ステージ(400)に基板(402)を設置して処理するプロセス中で、前記

基板(402)又は前記温度調節ステージ(400)の温度を測定する装置において、

前記温度調節ステージ(400)表面上に配置された温度センサ(600)と、

前記温度調節ステージ表面(400)と前記温度センサ(600)との間に介在する断熱材(605)と

を備える温度測定装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

本発明の第1の側面に従う温度測定装置は、温度調節ステージ(400)に基板(402)を設置して、前記基板(402)又は前記温度調節ステージ(400)の温度を測定する装置であって、前記基板(402)表面若しくはその近傍、又は前記温度調節ステージ(400)表面若しくはその近傍に、有意な面積を持った二次元温度センサ(600)を備え、前記二次元温度センサ(600)の面積に対応する前記基板(402)又は前記温度調節ステージ(400)の領域の温度を測定できるようになっている。